株式会社アドバンテスト
第 83 回定時株主総会 質疑応答要旨

【事前にインターネットで受け付けた意見】

- Q. デバイスがアップグレードされるたびにテストを買い替える必要があるか。それともソフトウェアの変更等で対応可能であるか教えてほしい。
- A. 昨今のテスト需要増加を牽引している AI 関連向けの高性能半導体に関して言えば、デバイスがアップグレードされると半導体がさらに複雑化されることになる。複雑化により半導体試験に必要な時間が増加し、その分テストの需要が増加する。アップグレードによりテストの買い替えが必要になるか、ソフトウェアで対応できるかはアップグレードの内容によるが、いずれの場合でも、テストまたはソフトウェアの売上は見込まれる。よって、デバイスのアップグレードは当社の事業のプラスに繋がる。
- Q. 汎用 AI GPU のテスト売上と今後の ASIC テストの売上比率は 2026 年および 2027 年 3 月期でどの程度になるか。ASIC が逆転すると考えるか。その場合いつ頃になりそうか。
- A. ASIC とは、特定用途向けのカスタム半導体の事であるが、我々はテスト需要に明るい見通しを持っており、ASIC の顧客も確実に増やしている。測定デバイスごとの売上比率を申しあげるとは控えさせていただくが、ASIC 向け半導体テストにおける商流は水平分業が主流であり、ASIC の製造委託先（ウェーハ、パッケージ）や半導体テスト業務を請け負う企業において非常に多くの V93000 シリーズをご使用いただいている。V93000 シリーズは、汎用 AI GPU 半導体や ASIC だけでなく、それ以外の SoC 半導体も非常に幅広くテストすることができる。そのため、ASIC 設計会社が、製造環境や生産ボリュームを見据えて安心して選択いただけるテストとなっている。このように汎用 AI GPU だけでなく、ASIC 向けテスト市場においても、当社のマーケット・シェアはさらに拡大していくものと期待している。
- Q. 高度技術に関する漏洩に対し、会社としてどのような対策をしているのか、教えてほしい。
- A. セキュリティおよびサイバー攻撃への対応は、最重要課題の一つとして捉えている。まず、ウイルスの感染などサイバー攻撃を防ぐため、最新の防御ソフトウェアを導入している。また、全社員に対して定期的に実例に沿った疑似メールを使った訓練と教育を実施している。その上で、サイバー攻撃およびネットワークを介した情報漏洩対策として、ネットワークの経路上に複数のチェックポイントを設け、必要な社員のみがアクセスし、その状況がログに記録されるような仕組みを構築している。さらに、情報を保持するサーバーにおいては、アクセスコントロールに加えて、一度に大量のダウンロードを行った場合や特定の機密度の高い情報にアクセスした場合にアラートを

出し、アクセスした社員を特定できる仕組みを設けている。また、物理的な情報漏洩対策として、印刷された文書（紙）を極秘、部外秘、社外秘および一般の区分に分類し、一般以外の文書については事業所内に鍵のかかるキャビネット等に保管し、持ち出し記録をつける運用を実施している。

- Q. 技術の進化が著しいこの業界で、今後どのように対応していく予定か。短期、中期、長期の視点から教えてほしい。
- A. 「半導体の複雑化」がキーワードだと考えている。短期的には、現在最も複雑な AI 関連の半導体（SoC およびメモリ双方）向けのテストソリューションを販売していく形になる。中長期的には、半導体試験の近縁市場へ展開することで、コア事業の“Automation of Test”を強化することになる。そして、3D 半導体、チップレット（複数の異なる半導体を組み合わせて一つにパッケージしたもの）、光半導体など、ますます進化する半導体へより良いソリューションをより早期に市場に提供して差別化を図るべく、他企業との連携や M&A も効果的な手法として引き続き検討していきたいと考えている。

【議場での質問】

- Q. 当社にはコンプライアンスを担当している CCO（Chief Compliance Officer）という役職があるようだが、担当している方は社外の方か、社内の方か、また、弁護士資格を有しているかを教えてほしい。
- A. （津久井社長）CCO は経営執行役員のキース ハードウィック氏が務めている。彼はアメリカ国籍である。彼自身は弁護士の資格を保有していないが、彼の所管する組織には弁護士の資格を持った従業員が在籍している。当社ビジネスはグローバルであるため、日本だけでなく世界各国に組織を設置しており、彼がチーフとしてその組織を取りまとめてオペレーションを行っている。
- Q. The Advantest Way（企業理念）として INTEGRITY という言葉が使われているが、この言葉の日本語の解釈をお聞きしたい。
- A. （津久井社長）企業文化については、マネジメントとして非常に力を入れている。当社は M&A を経験して海外従業員が全従業員の半数以上になった。グローバルにオペレーションしている企業として、当社は企業文化を全従業員に浸透させるかという視点から、INTEGRITY という企業理念を掲げた。社内では、INTEGRITY という言葉をそのまま英語で使用している。あえて日本語に訳すのであれば、真摯・誠実・高潔という言葉が当てはまる。当社の企業理念のユニークな点は INTEGRITY のそれぞれの頭文字をとってキーワードを組み合わせている点である。例えば、I は Innovation、N は Number One、T は Trust というように、我々がなりたい姿や大事に思っているものを

表現している。

Q. 第1号議案「定款一部変更の件」について、議決権基準日の変更を、当社のような会社が先行して行うことはとても画期的なことだと思う。議決権行使基準日を変更する決断に至った理由について、社外取締役であるベネシュ取締役からも話を伺いたい。

A. (津久井社長) 第1号議案の中で提案の理由として示したとおり、株主総会の前に有価証券報告書および事業報告を一体開示することにより、株主の皆さまにこれらの開示書類を十分に読み込んでいただける時間を取ってから株主総会を開催したいと考えた。この点については取締役会でも多く議論した。

(ベネシュ取締役) 現在は会社法および金融商品取引法に基づく2つの制度が両立している。長年、多くの会社が株主総会后に株主の皆さまにとって最も重要な開示情報である有価証券報告書を金融庁に提出するといった課題があった。株主総会前に必要な情報を開示し、機関投資家を含めた株主の皆さまに分析のための時間を十分に取っていただいた上で株主総会を開催することがガバナンスの観点からも望ましいと考えたため今回の決断に至った。

Q. 吉田前社長(現:吉田会長)体制時の説明会にて、競合他社のプローブカードメーカーとのパートナーシップ契約に関する状況について質疑があった。その時には、まだ様子を見るという回答だったが、本日の「第3期中期経営計画 進捗報告」の説明ではすでに3社とパートナーシップ契約を結んでいるとのことだった。これが中長期のテーマである近縁事業への展開であると解釈した。この3社を選定した理由およびこれからは消耗品ビジネスも視野に入れるのか等、今後の展望についてお伺いしたい。

A. (ラフィーバ Group CEO) プローブカード事業に投資した理由は2つある。1つ目は、デバイスの複雑化とともに、パッケージの中で複数のチップレットが使われており、ウェーハソート(ウェーハ上で行う電氣的テスト)およびダイレベルテスト(ウェーハから切り出したチップ(ダイ)の電氣的テスト)の重要性が増している。それに伴いプローブカードがより重要になると判断し、プローブカードメーカー上位3社に出資して関係を深めることにした。2つ目は競合他社が、あるプローブカードメーカーに出資したことに伴い、プローブカードメーカーとテストメーカーの中立性が崩れてきた。顧客は中立性を求めているので、それを回復するために3社に投資した。

(津久井社長) デバイスの複雑化に伴い半導体製造の工程も長くなっている。複雑なデバイスは高価であるため、パッケージ化された後に不良品と判定されると損失が大きくなる。そのためウェーハの段階でのテストが非常に重要となり、ウェーハテストにおいてプローブカードが必要になる。このような状況により、プローブカードメーカーとのパートナーシップの重要性が高まっているという背景がある。

Q. 中国での製造販売リスクについて伺いたい。中国における技術漏洩のリスクに対して

どのように対応をとっているか。

- A. (津久井社長) 当社は中国に現地法人を構えて今年で 30 年を迎える。昨今、米中間の問題も大きくなっているが、当社にとって中国市場は非常に重要なマーケットであることは間違いない。規制や法令に基づいて企業活動を行っている。一方で、情報セキュリティの問題は、米中双方の規制があり、システム的な対応策だけでなく、人材配置や情報の取り扱い、現地での開発や製造の内容等、徹底した情報管理を実施している。ただし、どのような対応も常にリスクを 100%回避できるわけではないと考えている。そのため、コーポレートレベルのリスクの最重要課題として、経営会議や取締役会にて議論している。また、グローバルに配置している現地社員と密にコミュニケーションを取り、常に改善対応策を検討している。

- Q. 現在、株価が上昇傾向にあり、東京証券取引所が公表している投資単位を引き下げる旨のガイダンスに対し、株価が大きく超えている状況であると思う。この点についてどのように考えているか。また、今後の株式分割の考え方について伺いたい。

- A. (津久井社長) 株式分割により株主の皆さまがより株を買やすくなり、株式の流動性を高めるための施策の一つであると認識している。当社は 2023 年 10 月 1 日を効力発生日として 1 : 4 の株式分割を実施した。今後は株式市場の動向や当社株価の水準、株主の構成等を総合的に勘案しながら引き続き検討していきたいと考えている。

- Q. この 1 年間、非常に高いパフォーマンスを実現していただき株主として感謝している。中長期的な市場拡大の展望として近縁市場の拡大を施策としているが、これは今後エコシステムのようなものを作っていくものと認識している。これは日本企業にとってチャレンジングなものだと思うが、当社が他社と違うと考えている点について聞かせていただきたい。また、このようなビジネスが ROIC にどのような影響を与えているのか伺いたい。

- A. (ラフィーバ Group CEO) まず、近縁市場の事業はそれぞれ独立した強固な事業基盤になっていくとともに、これらの事業は全社的な成長も押し上げるポテンシャルを持っていると考えている。同時に、HPC (ハイ・パフォーマンス・コンピューティング) および AI チップのテスト領域において、市場を牽引する立場を守り続けることも重要である。当社は現在、これらの領域において圧倒的な地位を確立している。HPC および AI チップ事業の市場は今後も成長が見込まれるため、現在の地位を維持し続けることが非常に重要であり、当社の成長をさらに押し上げるものと見込んでいる。当社のエコシステムについては、当社は市場の中でのポジションが非常に強固であるため、多くのパートナーが当社との協業に関心を持ってきている。このような当社のポジションを活用していきたいと考えている。

(津久井社長) 当社は半導体製造装置メーカーの中でたいへんユニークなポジションを築けている。半導体製造装置は主に量産現場に使われる装置が多いが、テストに関して

は半導体を設計する会社も当社の顧客である。半導体を設計するファブレス企業、ウェーハを製造するウェーハファウンドリー、パッケージを組み立てテストする OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 等すべてが当社の顧客である。このように当社は顧客との接点が圧倒的に多いため、情報も多く手に入り、エコシステムを作る時にも非常に優位に働くと考えている。ROIC については、中期経営計画にて目標を定めており、ラフィーバ Group CEO から説明がなされた戦略を推進することにより、結果的に企業価値をさらに高めていきたいと考えている。

- Q. ファブレス企業は予めファウンドリーやウェーハメーカーを決めていると思われるため、ファブレス企業に当社製品を納入できると自動的にファウンドリーやウェーハのビジネスが入ってくるような構造になっていると考えてよいか。また、それが参入障壁を築いていると考えてよいか。
- A. (津久井社長) SoC 半導体において主流である水平分業の流れについて説明する。水平分業は、設計を担うファブレス企業、ウェーハを製造するウェーハファウンドリー、組み立てテストを行う OSAT の 3 つに大きく分類される。どのテストを使うか決定するのは顧客ごとに異なるため、一概には申しあげられない。ただ、例えば新しい半導体を自分で設計して作りたいという顧客が最近いくつか出てきている。試作から量産段階へ移った時には、同じ物が大量に確保できるのかどうかという点が課題となる。当社はマーケットシェアが 58%あり、特にファブレス企業、ファウンドリーおよび OSAT のマーケットに関しては V93000 シリーズのシェアが非常に高い。新規参入したい、増産したいという顧客に対応できる点が我々の強みであると考えている。
- Q. アジアにおける国ごとの売上比率と、具体的な顧客名を伺いたい。
- A. (津久井社長) 個別の顧客に関する事情については回答を差し控える。地域別の売上は公開しているとおりであるが、出荷先別の記載となっているため、アジア以外の国の企業から注文があった場合でも出荷先がアジアであればアジアに分類されている。アジアでは AI/HPC 関連の売上比率が大きい台湾の数値が高い。その次に韓国、中国が並ぶ。
- Q. テスタにおけるアフターサービス市場はあまり大きくはないのか。また、収益性もそれほど高くないのか。
- A. (津久井社長) アフターサービスの市場は、現在、設置台数が非常に増えているため、そのポテンシャルは非常に大きいと考えている。また、デバイスが複雑化することにより、テストデータも非常に重要になってきており、それらを組み合わせてリカーリングビジネスを拡大していきたい。
- Q. 量子コンピュータの社会実装の実現性についてどのように考えているか伺いたい。ま

た、量子コンピュータが実装された場合のテストビジネスがどのように変貌すると考えているかイメージがあれば教えていただきたい。

- A. (ラフィーバ Group CEO) 量子コンピュータは我々も非常に注視している領域である。本格的に量子コンピュータが実装されるには、様々なアプリケーションで量子レベルのテストが必要となる。そして、(量子ビットは非常にデリケートで、外部環境からのわずかな干渉でも状態が変化してしまうため) 量子レベルのテストではデバイスを周囲から隔離する技術が重要になる。今後、当社の挑戦すべき分野であるため、引き続き積極的に研究開発を進めていく。

(津久井社長) CTO (Chief Technology Officer) を中心に研究している。量子コンピュータを動かすためには、その周辺に非常に複雑な半導体のシステムが必要であることが分かっているため、それをサポートすることで将来どのような課題があるのか明確になると考えている。

- Q. 当社グループの最終責任者はラフィーバ Group CEO か？津久井社長か？

A. (津久井社長) Group CEO のダグラス ラフィーバ氏が最終責任者である。

- Q. 今後の会社を作るのは人だと考えている。優秀な人財の確保という観点から今後の人件費に対する戦略を伺いたい。

A. (津久井社長) 人財は当社にとって最大の財産である。グローバルベースでどのように人財を採用し育成していくかについての戦略を持っている。人財戦略では、給与水準と企業文化の両面から考えることが重要であり、報酬については市場において競争力のあるスキームを常に保持する必要があると考えている。

- Q. 20年後、50年後、100年後といった超長期のプランがあれば伺いたい。

A. (津久井社長) 非常に不確実性が高い世の中で先を見通すのは難しい。当社視点のみで考えるのではなく、顧客とのコミュニケーションの中から事業の方向性を見出すのが長期視点において重要だと考えている。当社は非常に多くの顧客とコンタクトを持つことができおり、これが将来を見通す上で非常に大きな財産になっている。当社が重視している指標はマーケットシェアである。いかに顧客との信頼関係をつないで将来を語り合える関係でいることができるかが非常に重要であると考えている。100年後のプランは申しあげられないが、計測技術を軸に今後も発展を続けたいと考えている。

(ラフィーバ Group CEO) 当社の 70 年強の歴史を振り返ると、タケダ理研工業として産声をあげ、当時は据え置き型の計測機器から事業を始めた。その後、半導体製造装置事業へと事業拡大し、さらにテストセルソリューションを開発および提供する会社に発展してきた。今後の究極的なビジョンとしては、後工程の製造部分におけるテストフローに必要なすべてのソリューションを提供できる企業になりたいと思っている。

Q. 日本の半導体産業にアドバンテストと競合する会社はあるか。

A. (津久井社長) 非常に限られている。

Q. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) 等の従業員への金銭以外の報酬を支払うプランは持っているか。経営陣への報酬が多いように思うが従業員への報酬はどのようになっているか。

A. (津久井社長) 現在、一般従業員に対してもリテンションプログラムとして株式報酬を展開している。今後も様々な方法を検討し、競争力を高めたいと考えている。

Q. エンジニアの方の離職率を伺いたい。

A. (津久井社長) エンジニアの離職率は業界内で見ても非常に低い水準で推移している。マネジメントとしても非常に注視している。

【ライブ配信視聴者からのメッセージ】

Q. 昨年70周年記念式典が行われたようだが、工場勤務者を含めて祝うことはできたのか。

A. (津久井社長) 昨年無事70周年を迎えることができたのは、株主の皆さまのご支援があってこそだと考えている。昨年7月、従業員、従業員のご家族およびOB・OGの方々のために記念式典を行った。群馬工場勤務の従業員も対象としていたが、当時非常に好調な受注があり、生産対応のため出席できない従業員の方が非常に多くいた。そのため、10月に群馬工場にて別途従業員の感謝イベントを開催した。

以上